

2026年3月期第2四半期 決算説明会

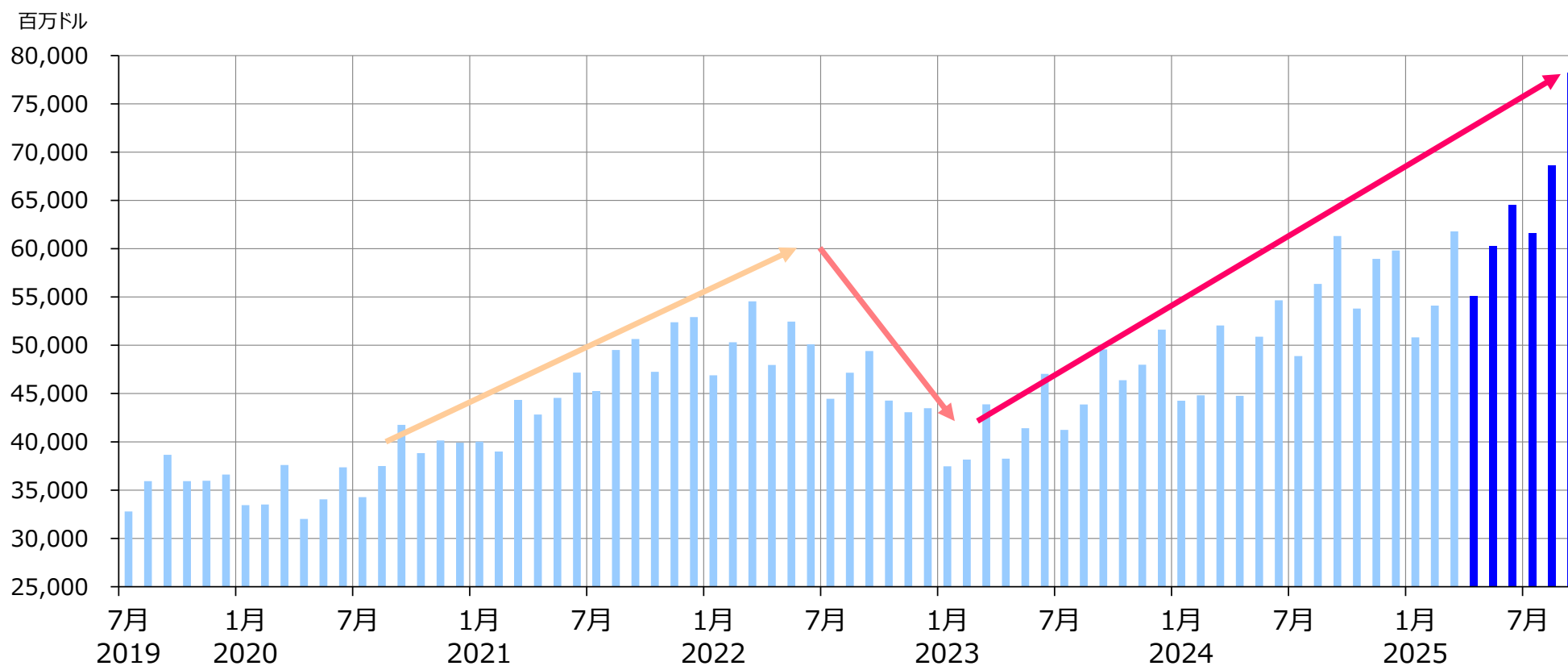
2025年11月12日

株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

FUJIAN
FUJIMI INCORPORATED

- ・2020年、新型コロナの影響で1月より下降　同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- ・2022年7月以降、生産及び在庫の調整が見られ減速、23年1月には2年半前（20年8月）の水準を割り込むまで下落
- ・その後、高価格のAI向け需要を追い風に金額ベースでは回復の様相を示すも、**数量ベースの本格的な回復**に向かうのか、今後の動向に注視が必要

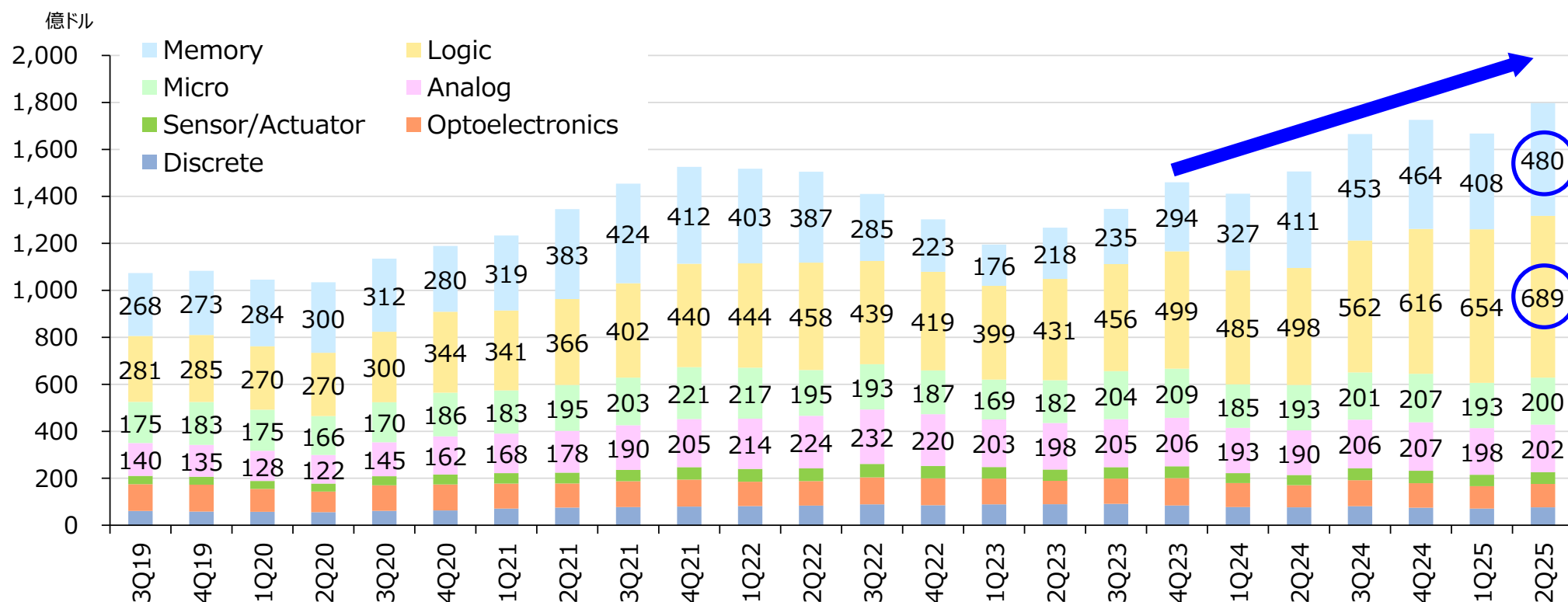


世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

・2Q25：メモリ QoQ +18%、ロジック QoQ +5%

・・・DRAM価格（特にDDR4）の上昇がメモリの大幅成長に寄与したと考えられる

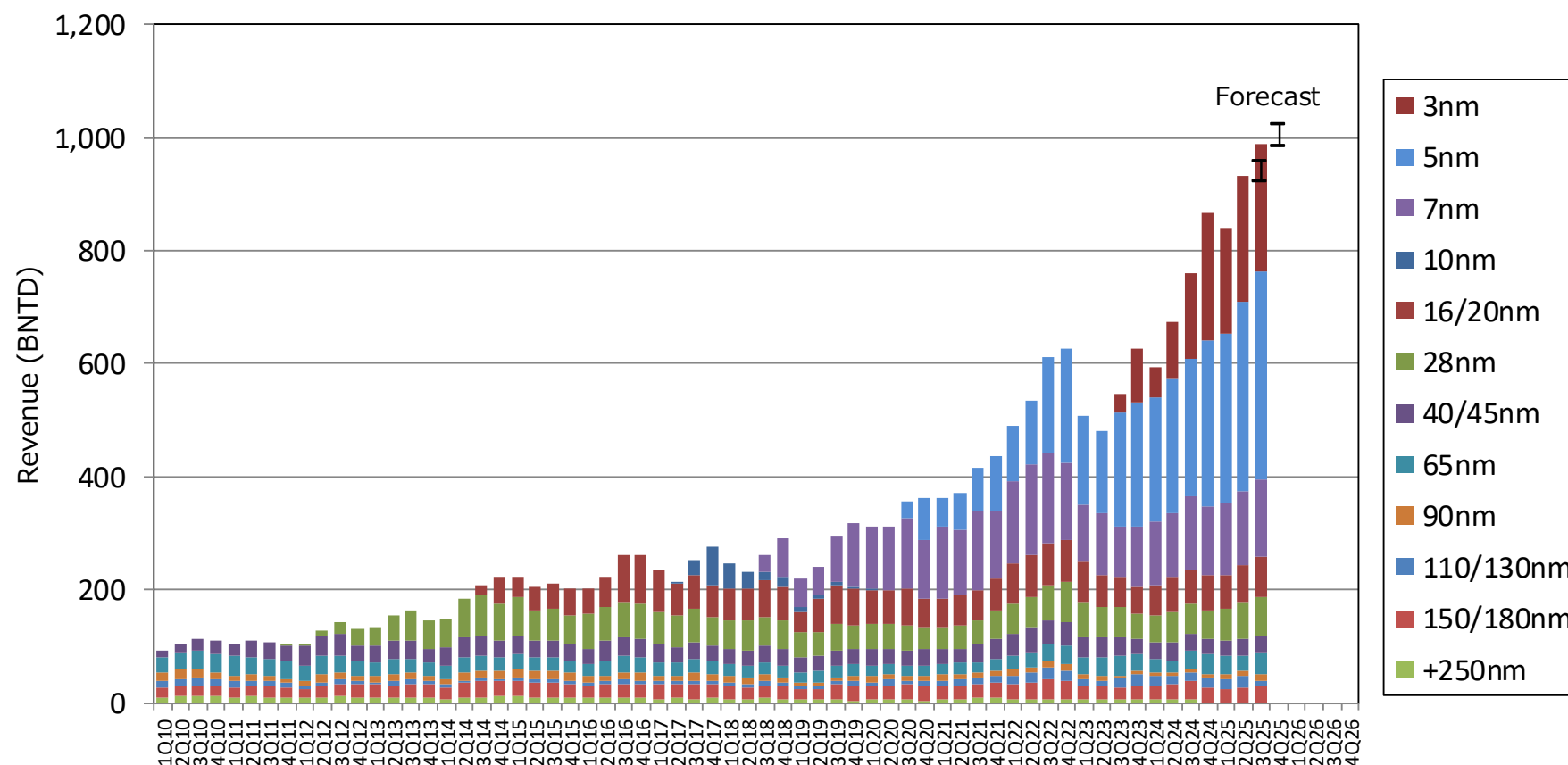


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2025年7-9月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

- ・25年3Q（7-9月期）：QoQ +6%, YoY +30% …エヌビディアをはじめとするAI向け需要の増加が牽引
- ・25年4Q（10-12月期）：ガイダンス QoQ -3% ~ +1%
- ・25年の設備投資計画：400-420億米ドル（24年通期 298億米ドル）

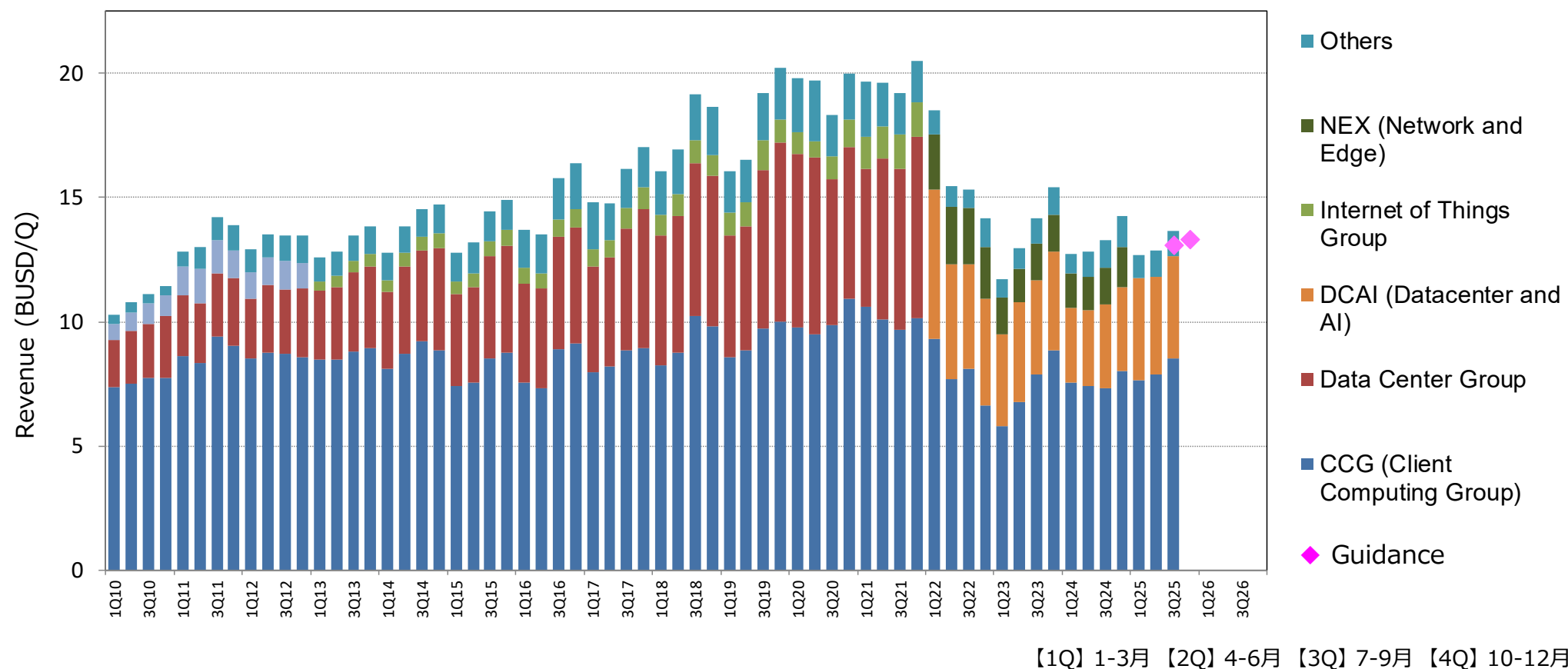


《暦年ベース》

インテル 売上高（2025年7-9月期）

出所：インテル公開情報よりフジミ作成

- 25年3Q（7-9月期）：売上高 QoQ +6%, YoY +3%・・・AI搭載PCの需要拡大がCCG事業の回復に貢献
- 25年4Q（10-12月期）：ガイダンス QoQ -7% ~ +1%

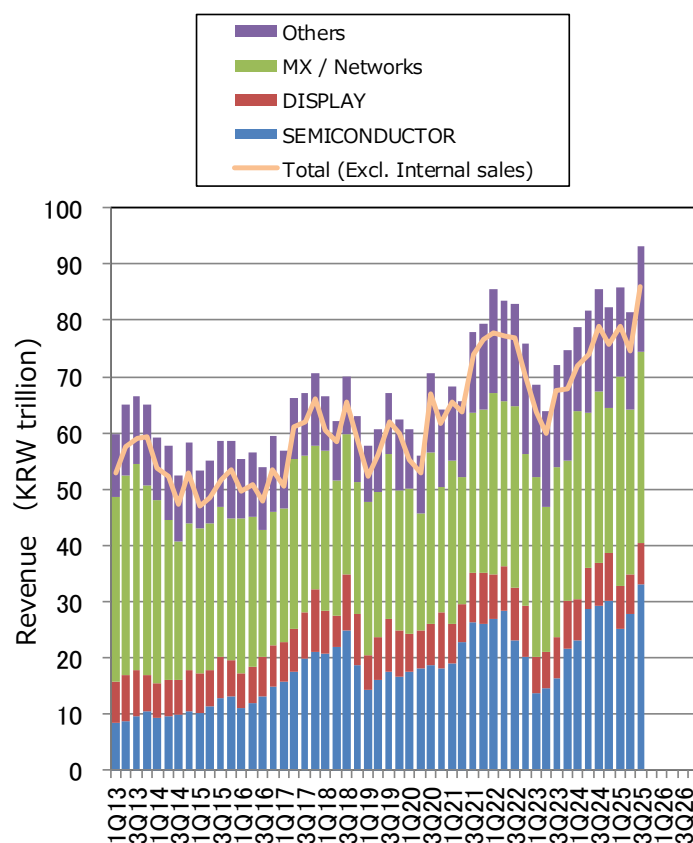


サムスン電子 売上高（2025年7-9月期）

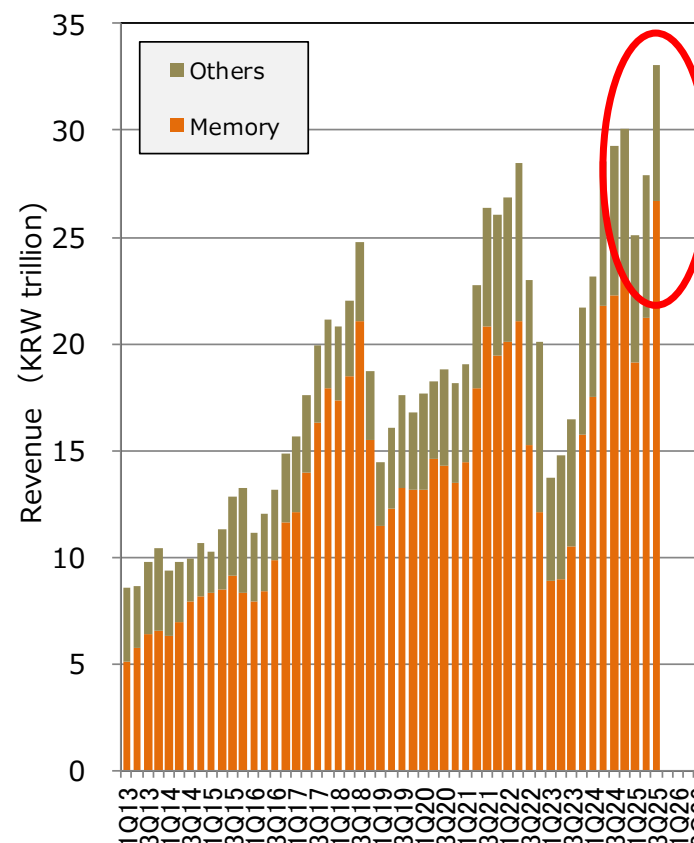
出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

- 半導体事業の25年3Q（7-9月期）売上高：QoQ +19%, YoY +13%・・・HBM3E、汎用DRAMの需要が好調に推移

<Samsung Total>



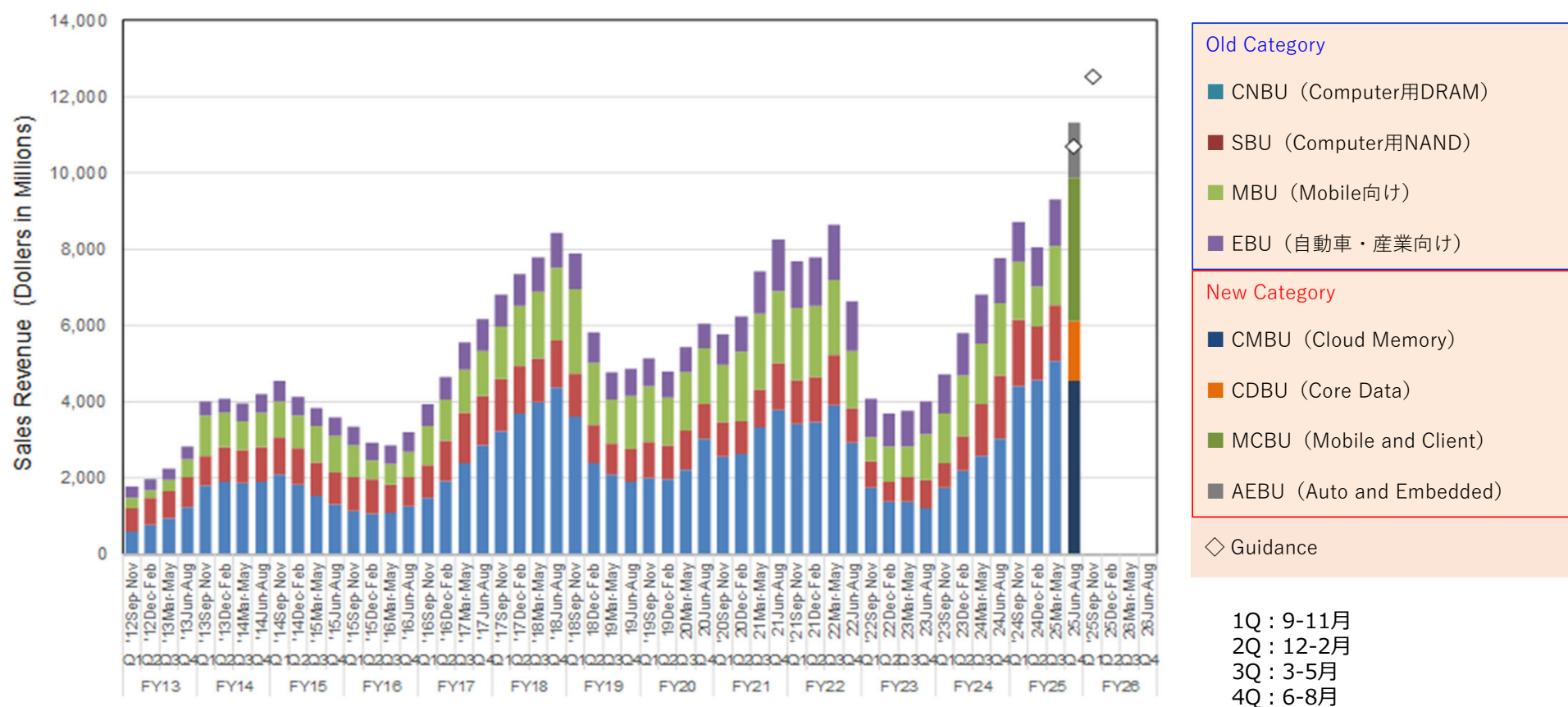
<Semiconductor Division>



《暦年ベース》

マイクロン・テクノロジー 売上高（2025年6-8月期）

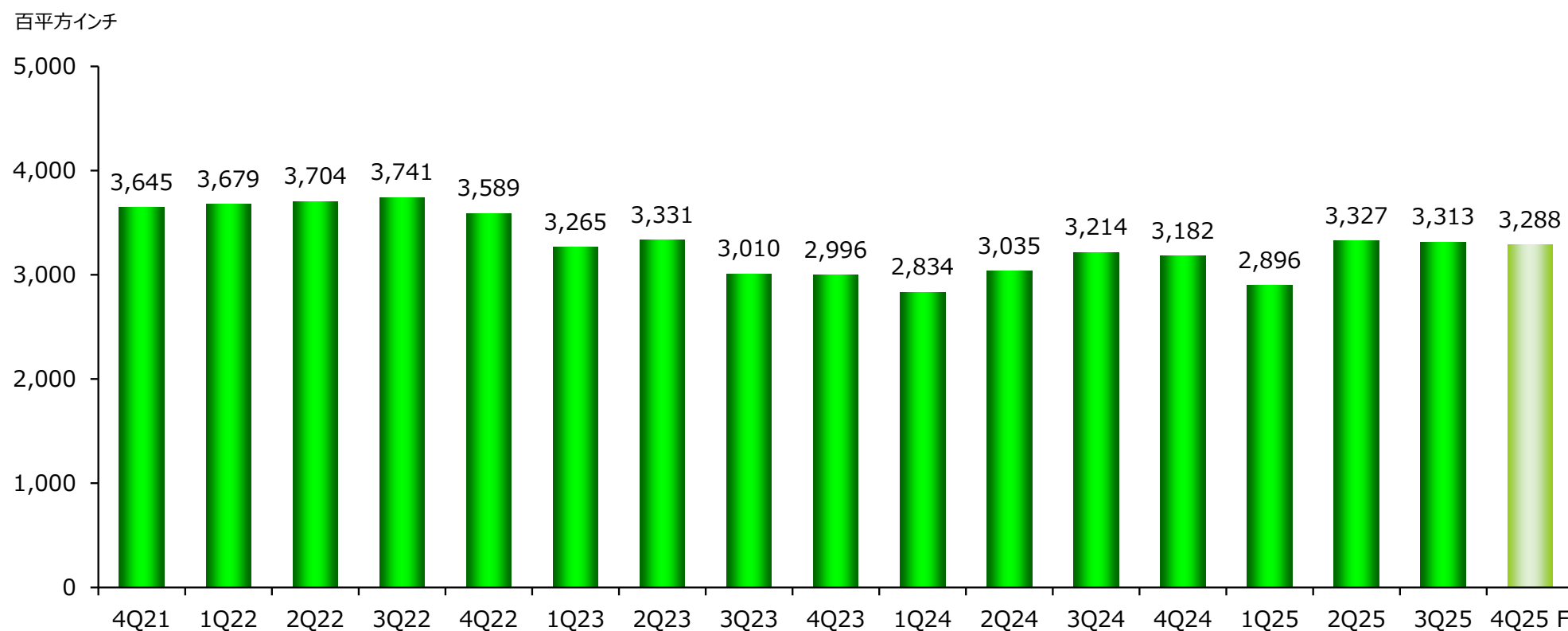
- 25年6- 8 月期 : QoQ +22%, YoY +46%・・・HBM好調継続
- 25年9-11月期 : ガイダンス QoQ +8 ~13%



シリコンウェハー出荷面積 実績（四半期）

出所：SEMI（2025/11/5）

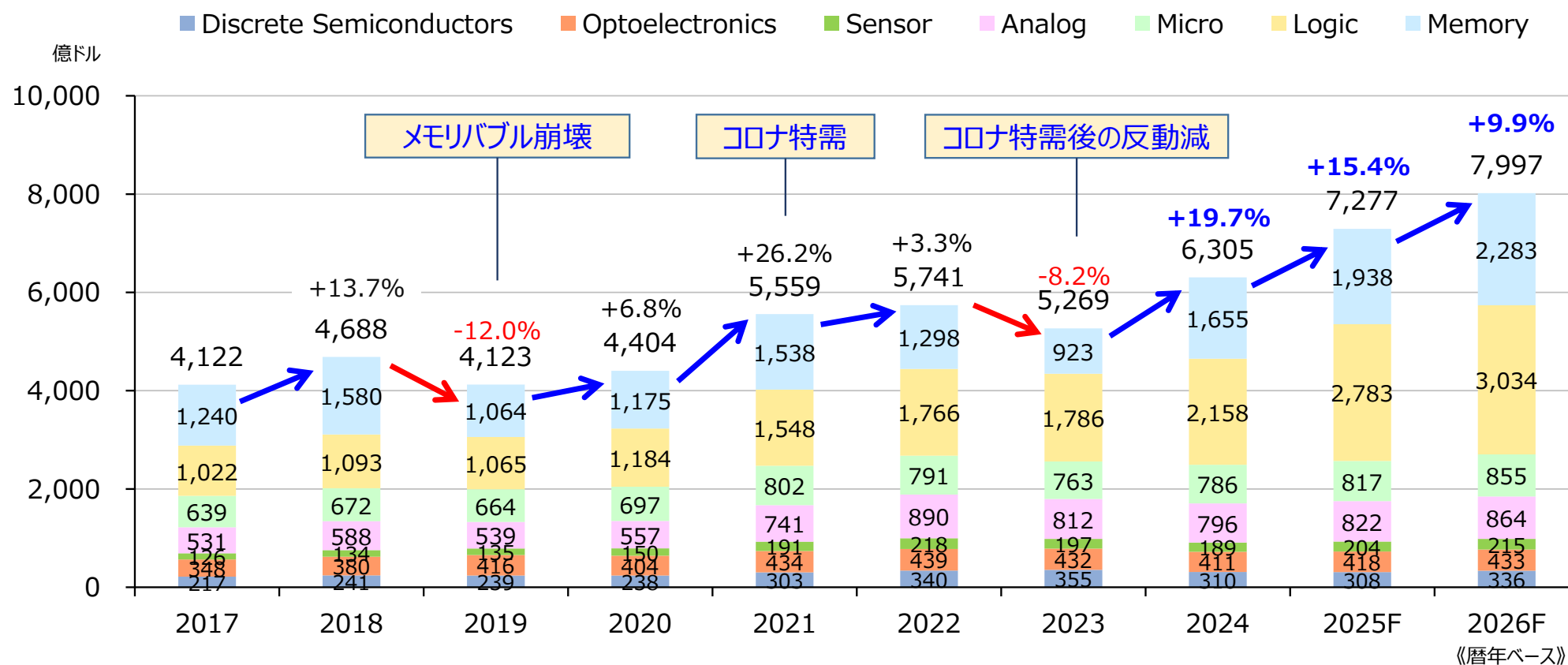
- ・25年3Q：QoQ **-0.4%**・・・エピタキシャルウェハーの回復鈍化
YoY **+3%**・・・AI関連投資の拡大に伴い、先端ロジック、クラウドインフラ、メモリ向けの需要が拡大
300mmウェハーの出荷量大幅増



世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2025/8/4）

- 2025年：+15.4%予想・・・AIデータセンター投資の恩恵を受けるメモリー、ロジック関連が成長を牽引
- 2026年： +9.9%予想・・・引き続きAIが牽引、エッジAIなどAIの応用分野拡大も成長の要因



決算概要

決算概要（上期実績）

*1 純利益：親会社株主に帰属する純利益 *2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期				
	上期実績	下期実績	期初予想 ('25/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
売上高	30,746	31,757	31,800	33,496	+8.9%	+5.5%	+5.3%
営業利益	5,702	6,077	5,950	6,469	+13.4%	+6.4%	+8.7%
率	18.5%	19.1%	18.7%	19.3%	-	-	-
経常利益	5,620	6,631	6,000	6,257	+11.3%	△5.6%	+4.3%
率	18.3%	20.9%	18.9%	18.7%	-	-	-
純利益 ^{*1}	4,370	5,058	4,400	4,671	+6.9%	△7.6%	+6.2%
率	14.2%	15.9%	13.8%	13.9%	-	-	-
EBITDA ^{*2}	6,645	7,138	7,050	7,533	+13.4%	+5.5%	+6.9%
率	21.6%	22.5%	22.2%	22.5%	-	-	-

・増収増益

為替実績：146.6円／ドル（前年同期：152.3円／ドル）

- 売上高：半期売上高としては過去最高を更新
- 営業利益：費用増（将来を見据えた投資に伴う増（含む人員増））があるも、先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向けポリシング材を中心に売上増加により増益
- 経常利益：台湾ドルが他通貨に対して独歩高となったことによる一時的な為替差損あり
- 純利益：経常利益の前年同期比+11.3%に対し、+6.9%。試験研究費控除制度変更等により控除額が減少したため

業績予想（通期予想）

*1 純利益：親会社株主に帰属する純利益 *2 EBITDA=営業利益+減価償却費

単位：百万円

	25年3月期	26年3月期			
	通期実績	期初予想	修正予想	前期比	期初予想比
売上高	62,503	65,300	67,900	+8.6%	+4.0%
営業利益	11,780	12,100	13,000	+10.4%	+7.4%
率	18.8%	18.5%	19.1%	-	-
経常利益	12,251	12,100	12,750	+4.1%	+5.4%
率	19.6%	18.5%	18.8%	-	-
純利益 ^{*1}	9,428	8,850	9,400	△0.3%	+6.2%
率	15.1%	13.6%	13.8%	-	-
EBITDA ^{*2}	13,783	14,800	15,300	+11.0%	+3.4%
率	22.1%	22.7%	22.5%	-	-

・売上高、営業・経常利益：増収増益予想

- 先端半導体デバイス向けCMP製品、シリコンウェハー向けポリシング材の販売増加を想定

・当期純利益：前期並み予想

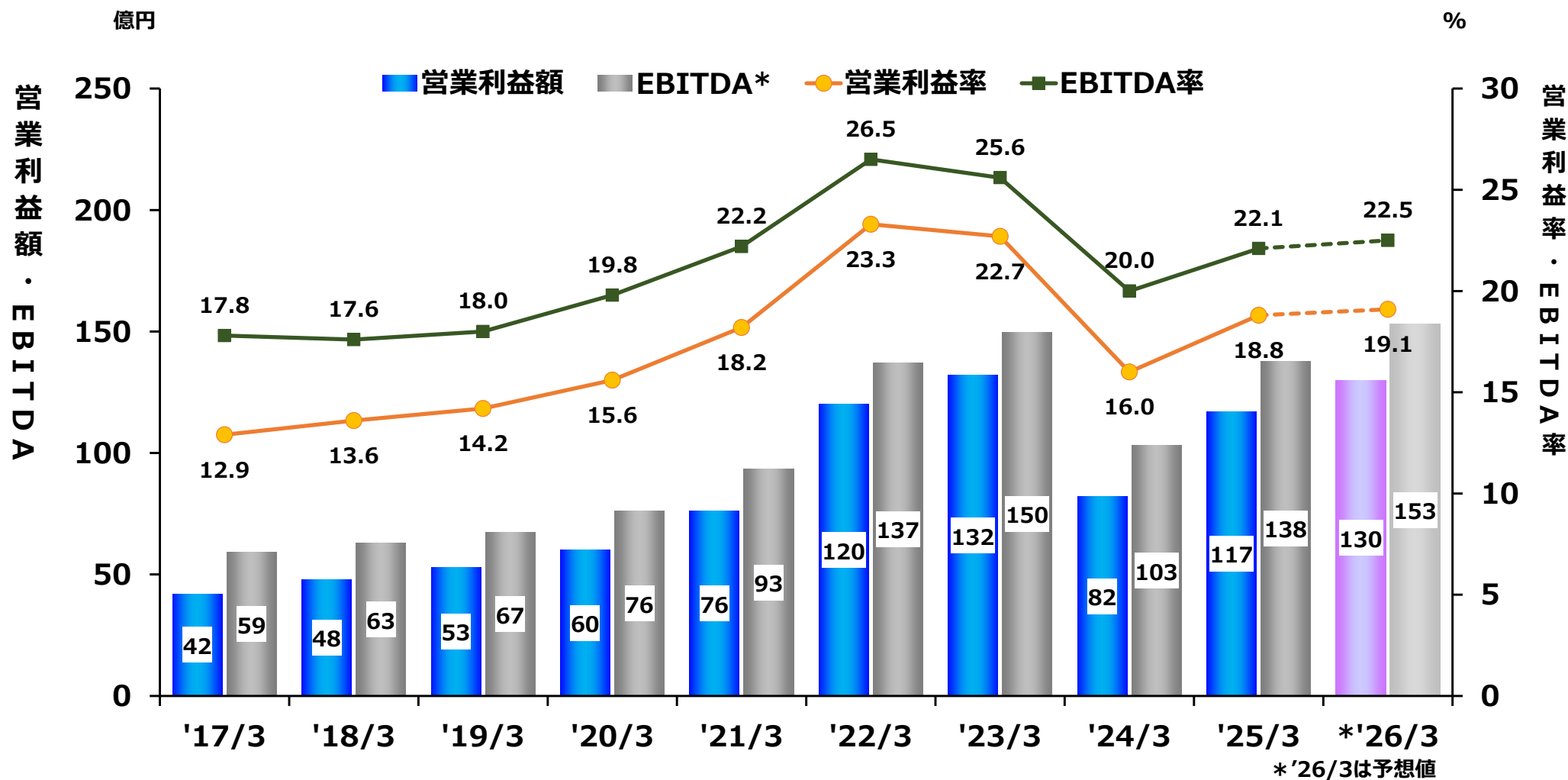
- 前期は賃上促進税制による税軽減あり

- 台湾ドルが他通貨に対して独歩高となったことによる一時的な為替差損あり

・想定為替レート：下期145.0円／ドル（前年下期実績：151.3円／ドル） 通期145.8円／ドル（前期実績：152.4円／ドル）

営業利益、EBITDA（今期予想含む）

* EBITDA=営業利益+減価償却費



用途別売上高

用途別売上高（上期実績）

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期				
		上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
シリコン	ラッピング	3,791	3,772	3,750	3,711	△2.1%	△1.6%	△1.0%
	ポリシング	6,123	6,574	6,550	6,928	+13.1%	+5.4%	+5.8%
	切断	81	94	100	52	△35.6%	△44.7%	△47.7%
	計	9,996	10,441	10,400	10,692	+7.0%	+2.4%	+2.8%
CMP		15,033	15,625	15,600	16,732	+11.3%	+7.1%	+7.3%
ディスク		1,290	1,256	1,200	1,000	△22.5%	△20.4%	△16.7%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,639	2,775	3,000	3,511	+33.1%	+26.5%	+17.1%
	一般工業用(非研磨材)	1,708	1,605	1,550	1,532	△10.3%	△4.6%	△1.2%
	計	4,348	4,381	4,550	5,044	+16.0%	+15.1%	+10.9%
製品売上高		30,668	31,705	31,750	33,468	+9.1%	+5.6%	+5.4%
商品売上高		78	51	50	28	△63.8%	△45.6%	△43.6%
売上高 合計		30,746	31,757	31,800	33,496	+8.9%	+5.5%	+5.3%

用途別売上高（四半期実績）

単位：百万円

		25年3月期				26年3月期					
		1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 実績	1Q 実績	前年 同期比	前年 4Q比	2Q 実績	前年 同期比	同年 1Q比
シリコン	ラッピング	1,796	1,994	1,966	1,806	1,822	+1.5%	+0.9%	1,888	△5.3%	+3.6%
	ポリシング	2,857	3,266	3,298	3,275	3,396	+18.9%	+3.7%	3,531	+8.1%	+4.0%
	切断	43	38	44	49	34	△20.4%	△31.1%	17	△52.8%	△47.7%
	計	4,696	5,299	5,310	5,131	5,253	+11.9%	+2.4%	5,438	+2.6%	+3.5%
CMP		7,372	7,660	8,002	7,623	8,268	+12.2%	+8.5%	8,463	+10.5%	+2.4%
ディスク		605	685	655	601	453	△25.0%	△24.5%	546	△20.3%	+20.3%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,203	1,435	1,225	1,549	1,648	+37.0%	+6.4%	1,863	+29.8%	+13.0%
	一般工業用(非研磨材)	830	877	813	792	756	△9.0%	△4.5%	775	△11.6%	+2.5%
	計	2,034	2,313	2,039	2,342	2,405	+18.2%	+2.7%	2,638	+14.1%	+9.7%
製品売上高		14,709	15,958	16,006	15,698	16,381	+11.4%	+4.4%	17,087	+7.1%	+4.3%
商品売上高		29	48	39	12	12	△56.3%	+3.9%	15	△68.5%	+18.2%
売上高 合計		14,738	16,007	16,046	15,710	16,394	+11.2%	+4.4%	17,102	+6.8%	+4.3%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

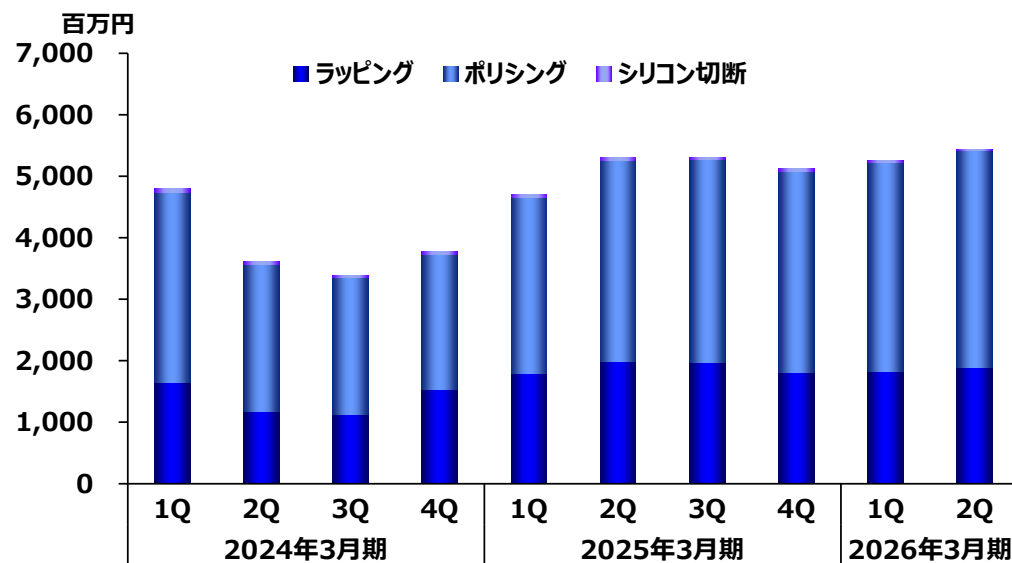
		25年3月期	26年3月期			
		通期実績	期初予想	修正予想	前期比	期初予想比
シリコン	ラッピング	7,563	7,650	7,450	△1.5%	△2.6%
	ポリシング	12,698	13,250	13,850	+9.1%	+4.5%
	切断	175	200	100	△43.2%	△50.0%
	計	20,437	21,100	21,400	+4.7%	+1.4%
CMP		30,658	31,600	34,500	+12.5%	+9.2%
ディスク		2,547	2,550	2,100	△17.6%	△17.6%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,415	6,600	6,700	+23.7%	+1.5%
	一般工業用(非研磨材)	3,314	3,350	3,150	△5.0%	△6.0%
	計	8,729	9,950	9,850	+12.8%	△1.0%
製品売上高		62,373	65,200	67,850	+8.8%	+4.1%
商品売上高		129	100	50	△61.5%	△50.0%
売上高 合計		62,503	65,300	67,900	+8.6%	+4.0%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期				
		上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
シリコン	ラッピング	3,791	3,772	3,750	3,711	△2.1%	△1.6%	△1.0%
	ポリシング	6,123	6,574	6,550	6,928	+13.1%	+5.4%	+5.8%
	切断	81	94	100	52	△35.6%	△44.7%	△47.7%
	計	9,996	10,441	10,400	10,692	+7.0%	+2.4%	+2.8%



・事業環境

- 市場におけるシリコンウェハー在庫は依然として高水準
- 小口径ウェハー市場は依然として弱い

・ラッピング、ポリシング製品の業績要因

- ラッピング：小口径向けの需要が弱く微減
- ポリシング：主に先端向けの販売好調による増収

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

- ・下期も300mm先端向けは好調維持。下期は上期並みを想定するも、通期では前期比4.7%増収を見込む
- ・ただし、シリコンウェハーの全体としては、本格的な回復には今しばらく時間を要するものと思われる

「下期」

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期 期初予想	下期 修正予想	前年同期比	上期比	期初予想比
シリコン	ラッピング	3,791	3,772	3,711	3,900	3,738	△0.9%	+0.7%	△4.2%
	ポリシング	6,123	6,574	6,928	6,700	6,921	+5.3%	△0.1%	+3.3%
	切断	81	94	52	100	48	△49.3%	△8.3%	△52.0%
	計	9,996	10,441	10,692	10,700	10,707	+2.5%	+0.1%	+0.1%

「通期」

単位：百万円

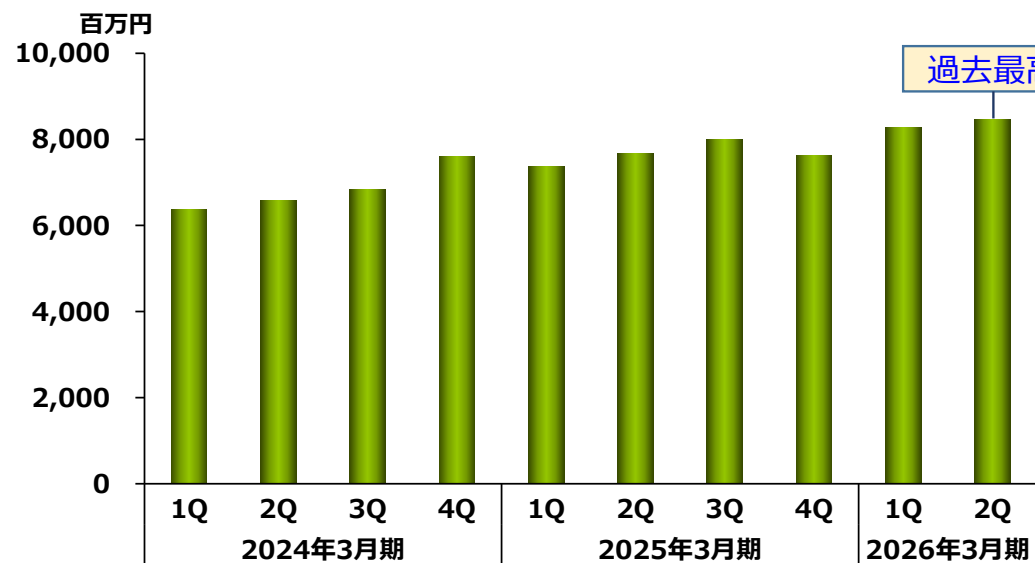
		25年3月期	26年3月期			
		通期実績	期初予想	修正予想	前期比	期初予想比
シリコン	ラッピング	7,563	7,650	7,450	△1.5%	△2.6%
	ポリシング	12,698	13,250	13,850	+9.1%	+4.5%
	切断	175	200	100	△43.2%	△50.0%
	計	20,437	21,100	21,400	+4.7%	+1.4%

CMP売上高（上期実績）

≪上期≫

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期				
	上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
CMP	15,033	15,625	15,600	16,732	+11.3%	+7.1%	+7.3%



・事業環境

- AI向け先端半導体デバイスの需要は堅調
- P Cやスマートフォン、車載向け等の需要に底打ち感が見られつつある

・CMP向け製品の増収要因

- AI関連の先端ロジック、先端メモリ向け販売好調により四半期・半期としての売上はいずれも過去最高

CMP売上高（下期予想・通期予想）

・PC、スマホ、EVを含めた半導体全体の本格的な回復には今しばらく時間を要すると思われるが、AI向け先端半導体デバイスの需要は堅調であり、前期比増収を見込む

「下期」

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期 期初予想	下期 修正予想	前年同期比	上期比	期初予想比
CMP	15,033	15,625	16,732	16,000	17,768	+13.7%	+6.2%	+11.1%

「通期」

単位：百万円

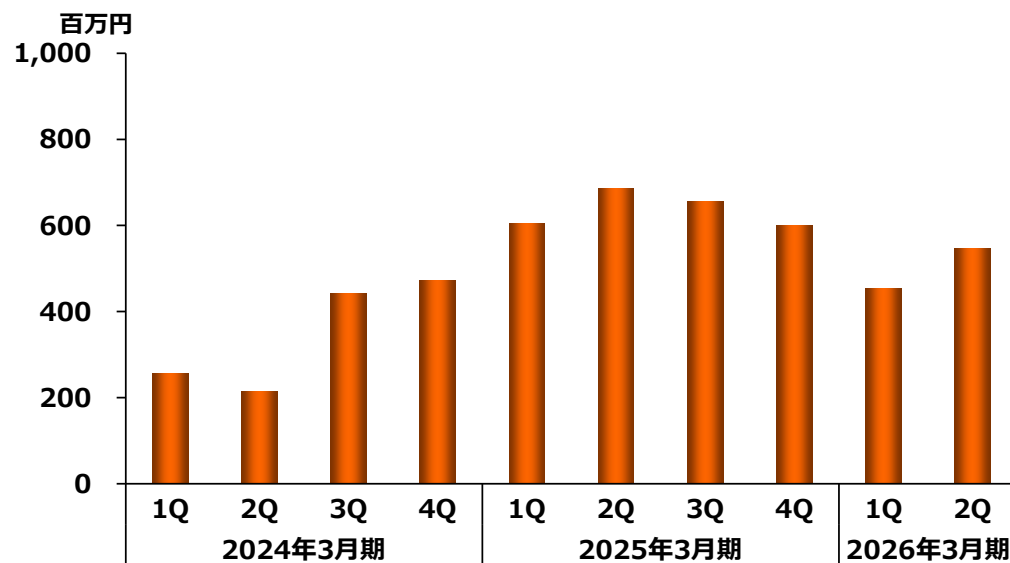
	25年3月期	26年3月期			
	通期実績	期初予想	修正予想	前期比	期初予想比
CMP	30,658	31,600	34,500	+12.5%	+9.2%

ディスク売上高（上期実績）

«上期»

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期				
	上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
ディスク	1,290	1,256	1,200	1,000	△22.5%	△20.4%	△16.7%



- ・ 事業環境
 - データセンター向けHDDの需要は堅調
- ・ 減収要因
 - 顧客の生産プロセス改善の影響により、当社研磨材使用量が減少

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

・ データセンター向けHDDの需要は高水準で推移すると想定し、下期は上期比で増収となるも、顧客プロセス改善の影響により、通期では前期比減収を見込む

「下期」

単位：百万円

	25年3月期		26年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期 期初予想	下期 修正予想	前年同期比	上期比	期初予想比
ディスク	1,290	1,256	1,000	1,350	1,100	△12.5%	+10.0%	△18.5%

「通期」

単位：百万円

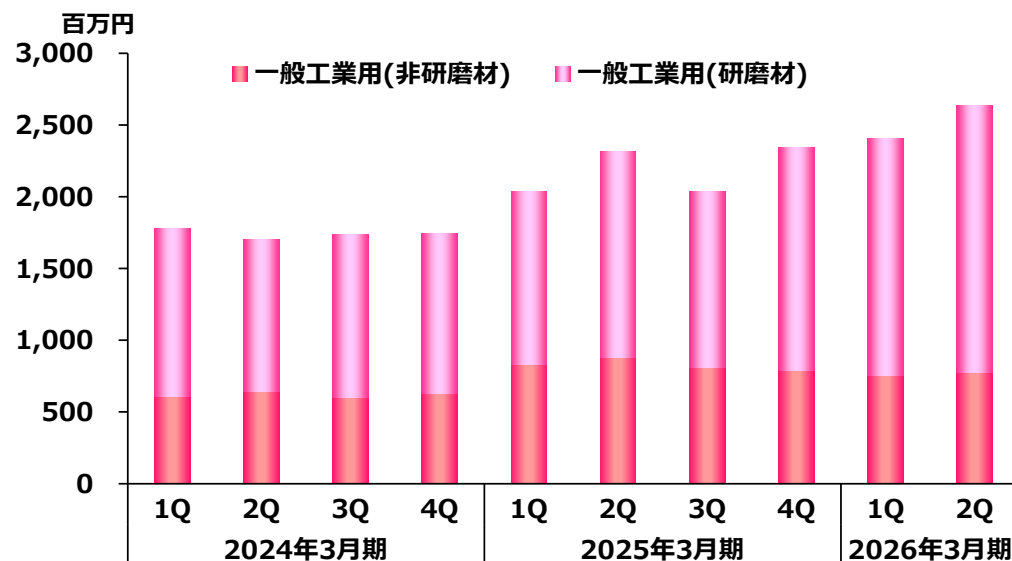
	25年3月期	26年3月期			
	通期実績	期初予想	修正予想	前期比	期初予想比
ディスク	2,547	2,550	2,100	△17.6%	△17.6%

機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		25年3月期		26年3月期				
		上期実績	下期実績	期初予想	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,639	2,775	3,000	3,511	+33.1%	+26.5%	+17.1%
	一般工業用(非研磨材)	1,708	1,605	1,550	1,532	△10.3%	△4.6%	△1.2%
	計	4,348	4,381	4,550	5,044	+16.0%	+15.1%	+10.9%



・事業環境

- 産業機械市場は横ばい
- NAND向け半導体製造装置の設備投資は低調

・一般工業用（研磨材）の増収要因

- 産業機械向け研磨材等の需要は横ばい
- 前期に子会社化した南興セラミックスの売上合算
- 研磨装置関連のスポット受注あり

・一般工業用（非研磨材）の減収要因

- NAND向け半導体製造装置向け製品の需要減少

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

・ 研磨材は南興セラミックスの子会社化により増収、非研磨材は鉄鋼及び産業機械向け溶射材の需要が低調に推移するものと想定し減収を見込む

「下期」

単位：百万円

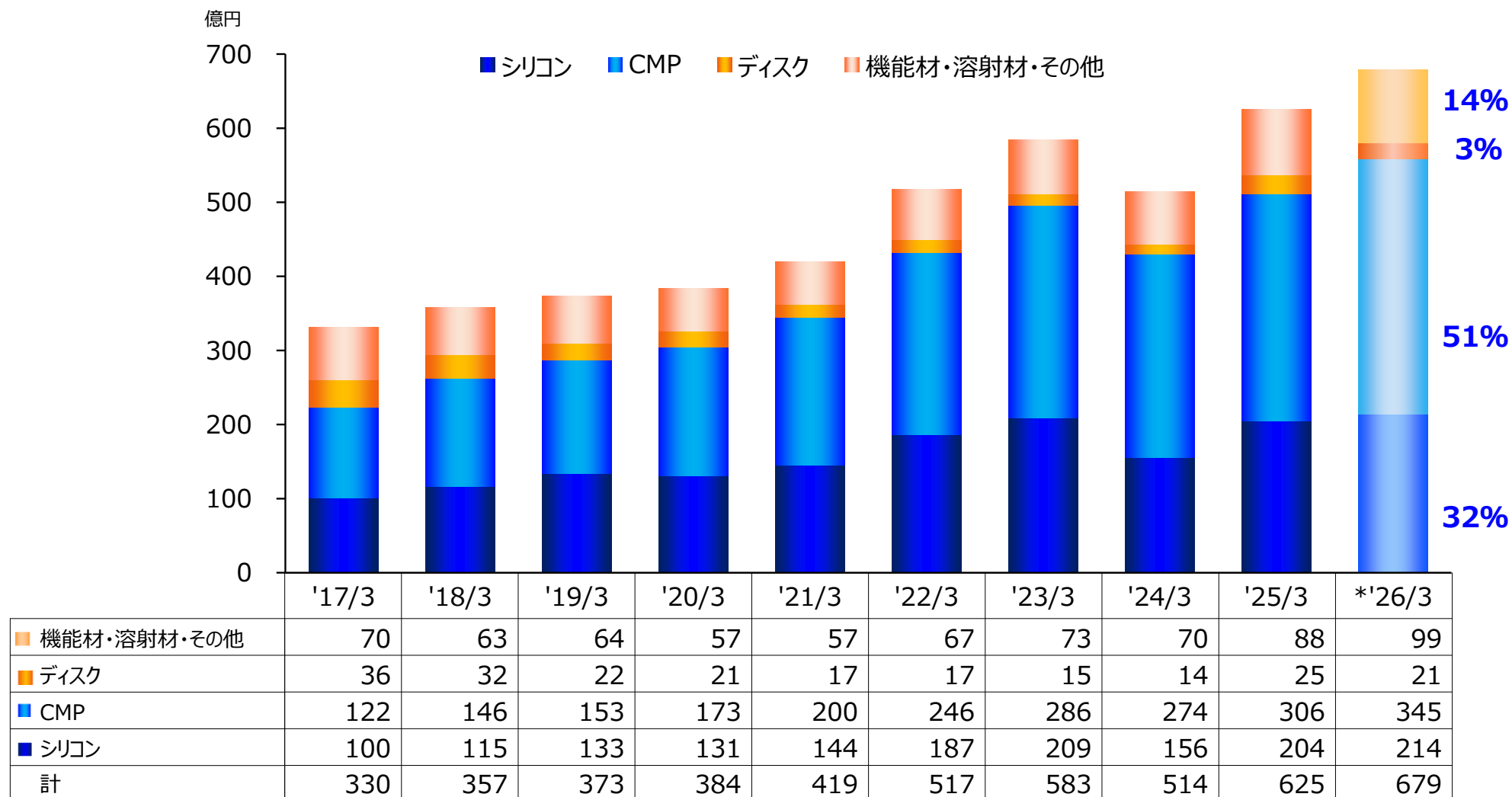
		25年3月期		26年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期 期初予想	下期 修正予想	前年同期比	上期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,639	2,775	3,511	3,600	3,189	+14.9%	△9.2%	△11.4%
	一般工業用(非研磨材)	1,708	1,605	1,532	1,800	1,618	+0.8%	+5.6%	△10.1%
	計	4,348	4,381	5,044	5,400	4,807	+9.7%	△4.7%	△11.0%

「通期」

単位：百万円

		25年3月期	26年3月期			
		通期実績	期初予想	修正予想	前期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	5,415	6,600	6,700	+23.7%	+1.5%
	一般工業用(非研磨材)	3,314	3,350	3,150	△5.0%	△6.0%
	計	8,729	9,950	9,850	+12.8%	△1.0%

用途別売上高（通期）



設備投資額 減価償却費 研究開発費

中期的な設備投資計画

2022年6月 2022年3月期決算説明会資料再掲

- ・ 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- ・ 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

各務山新工場建設（計画）

敷地面積：28千㎡

’21年12月に売買契約を締結

- ・ シリコン、CMP製品の生産能力増強

FUJIMI CORPORATION（米国）

既存工場敷地内に新棟建設を計画

- ・ CMP生産スペース拡大

FUJIMI TAIWAN（台湾）

- ・ 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画

- ・ 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

第2開発センター（仮称）建設（計画）

敷地面積：16千㎡

現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済

- ・ 非半導体関連の研究施設を設置



中期的な設備投資計画（アップデート）

2024年11月 2025年3月期第2四半期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
<p>各務山新工場建設</p> <p>敷地面積：28千㎡</p> <p>’21年12月に売買契約を締結</p> <ul style="list-style-type: none"> シリコン、CMP製品生産能力増強 	<p>’24年10月 着工</p> <p>’25年末 竣工</p> <p>’26年中 試作品出荷</p> <p>’27年中 本格生産開始</p>	<p>【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設</p> <p>【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済</p>
<p>FUJIMI CORPORATION（米国）</p> <p>既存工場敷地内に新棟建設を計画</p> <ul style="list-style-type: none"> CMP製品生産スペース拡大 SiC用製品 	<p>新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え）</p> <p>’25年末 設備設置完了</p>	<p>2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設</p>
<p>FUJIMI TAIWAN（台湾）</p> <ul style="list-style-type: none"> 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画 	<p>’25年末 導入完了</p> <p>’26年 生産開始</p>	<p>2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を当下期に開始予定</p>

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

<p>第2開発センター(仮称)建設</p> <p>敷地面積：16千㎡</p> <p>現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済</p> <ul style="list-style-type: none"> 非半導体関連の研究施設を設置 	<p>’25年5月着工に向けて予定通り進捗（詳細設計中）</p>
---	----------------------------------


中期的な設備投資計画（アップデート）

2025年5月 2025年3月期決算説明会資料再掲

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
各務山新工場建設 敷地面積：28千㎡ '21年12月に売買契約を締結 ・シリコン、CMP製品生産能力増強	'24年10月 着工 '25年末 竣工 '26年中 試作品出荷 '27年中 本格生産開始	【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設 【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済
FUJIMI CORPORATION（米国） 既存工場敷地内に新棟建設を計画 ・CMP製品生産スペース拡大 ・SiC用製品	新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え） '25年末 設備設置完了	2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設
FUJIMI TAIWAN（台湾） ・建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画	'25年末 導入完了 '26年 生産開始	2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の 検討を開始

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資


第2開発センター(仮称)建設 敷地面積：16千㎡ 現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済 ・非半導体関連の研究施設を設置	'25年5月 着工 '26年10月 竣工 完成予想図→	
---	---------------------------------------	---

中期的な設備投資計画（アップデート）

- 半導体市場の旺盛な需要に応える生産設備投資
- 先端半導体向け製品に対して高まる品質要求に応える研究開発及び品質保証関連投資

計画概要	現状（スケジュール）	将来計画
<p>各務山新工場建設</p> <p>敷地面積：28千㎡</p> <p>’21年12月に売買契約を締結</p> <ul style="list-style-type: none"> シリコン、CMP製品生産能力増強 	<p>’24年10月 着工</p> <p>’25年末 竣工</p> <p>’26年中 試作品出荷</p> <p>’27年中 本格生産開始</p>	<p>【Phase2】顧客需要を見ながら、しかるべきタイミングで新工場内に生産ライン増設</p> <p>【Phase3】2030年以降の需要に備え、当上期に新工場隣接の工場用地(34千㎡)を取得済</p>
<p>FUJIMI CORPORATION（米国）</p> <p>既存工場敷地内に新棟建設を計画</p> <ul style="list-style-type: none"> CMP製品生産スペース拡大 SiC用製品は市場動向を鑑み見送り 	<p>新棟建設計画を既存建屋内空きスペースの生産ライン増強に切替（工期長期化懸念に備え）</p> <p>’25年末 設備設置完了</p>	<p>2030年以降の需要に備え、敷地内（又は新たに取得した土地）に新工場棟を建設</p>
<p>FUJIMI TAIWAN（台湾）</p> <ul style="list-style-type: none"> 建屋増築は既に完了、順次CMP生産設備の導入を計画 	<p>’25年末 導入完了</p> <p>’26年 生産開始</p>	<p>2030年以降の需要に備え、新たな工場用地の検討を開始</p>

- 中期視点での研究開発と新規事業の探索・育成のための投資

<p>第2開発センター(仮称)建設</p> <p>敷地面積：16千㎡</p> <p>現研究開発センター近隣の岐阜県テクノプラザ内に用地取得済</p> <ul style="list-style-type: none"> 非半導体関連の研究施設を設置 	<p>’25年5月 着工</p> <p>’26年10月 竣工</p> <p>完成予想図→</p>	
---	--	---

中期的な設備投資計画（各務山新工場アップデート）

各務山新工場 完成予想図



✓ 25年末の竣工に向けて建設工事は予定通り進捗

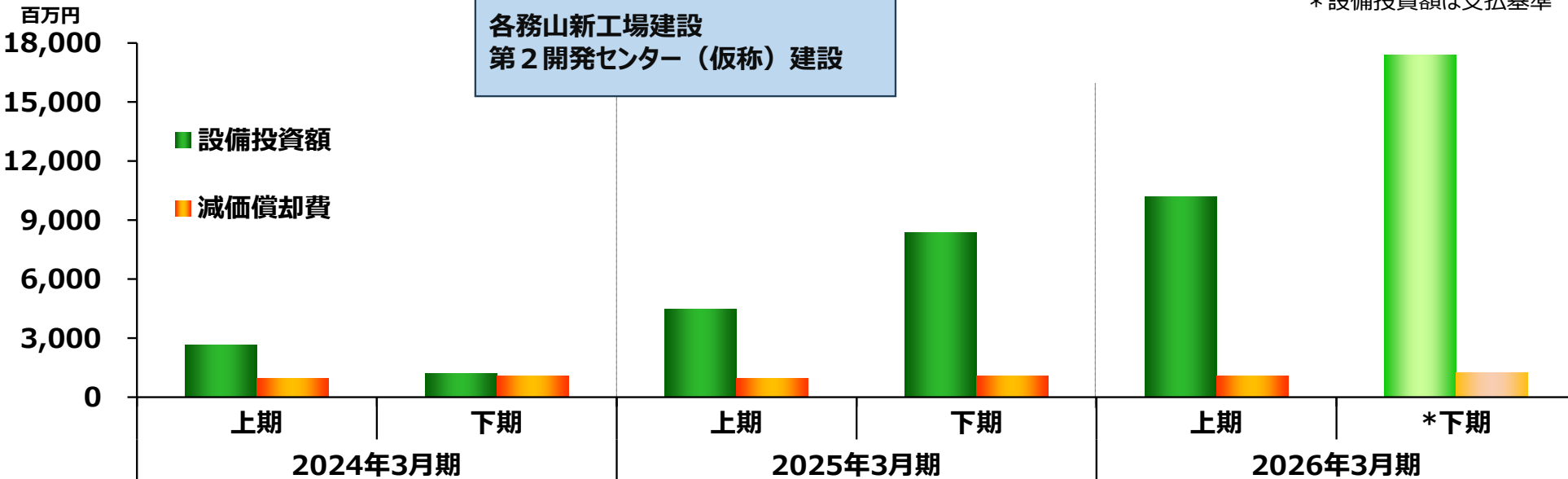
新工場工事写真（11月3日撮影）



設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

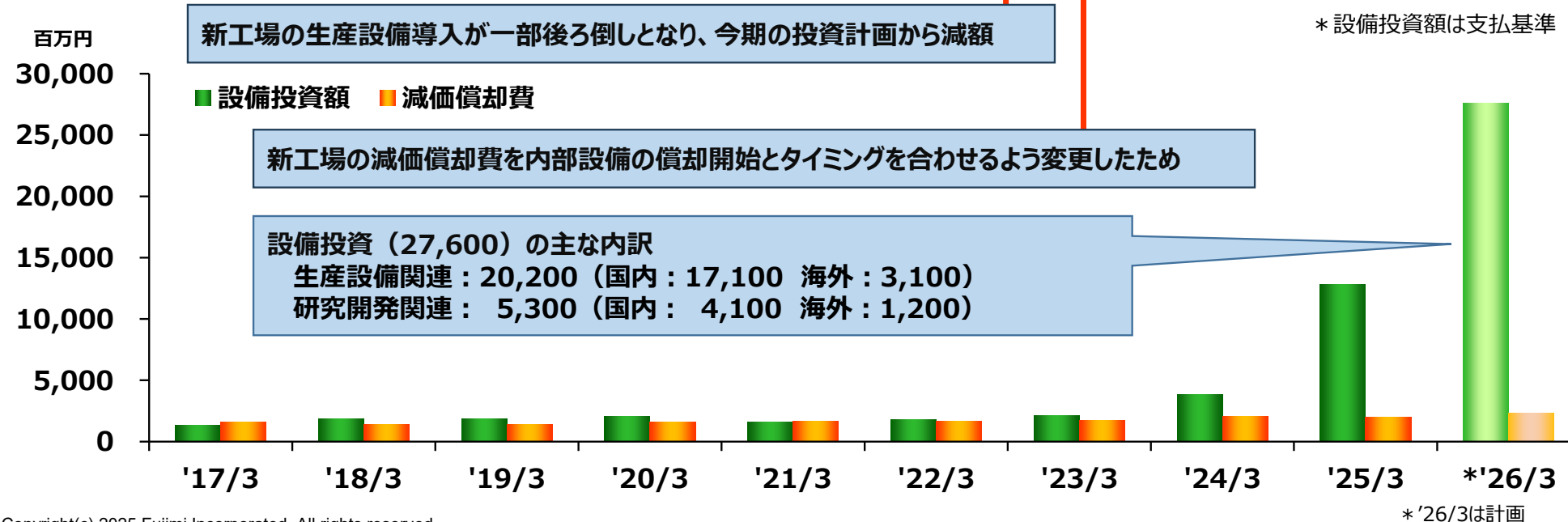
	25年3月期		26年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('25/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比	下期計画 ('25/5)	下期修正計画	前年同期比	同年上期比	計画比
設備投資額	4,473	8,371	13,800	10,201	+128.1%	+21.9%	△26.1%	15,800	17,399	+107.8%	+70.6%	+10.1%
減価償却費	942	1,060	1,100	1,064	+12.9%	+0.4%	△3.3%	1,600	1,235	+16.6%	+16.2%	△22.8%



設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

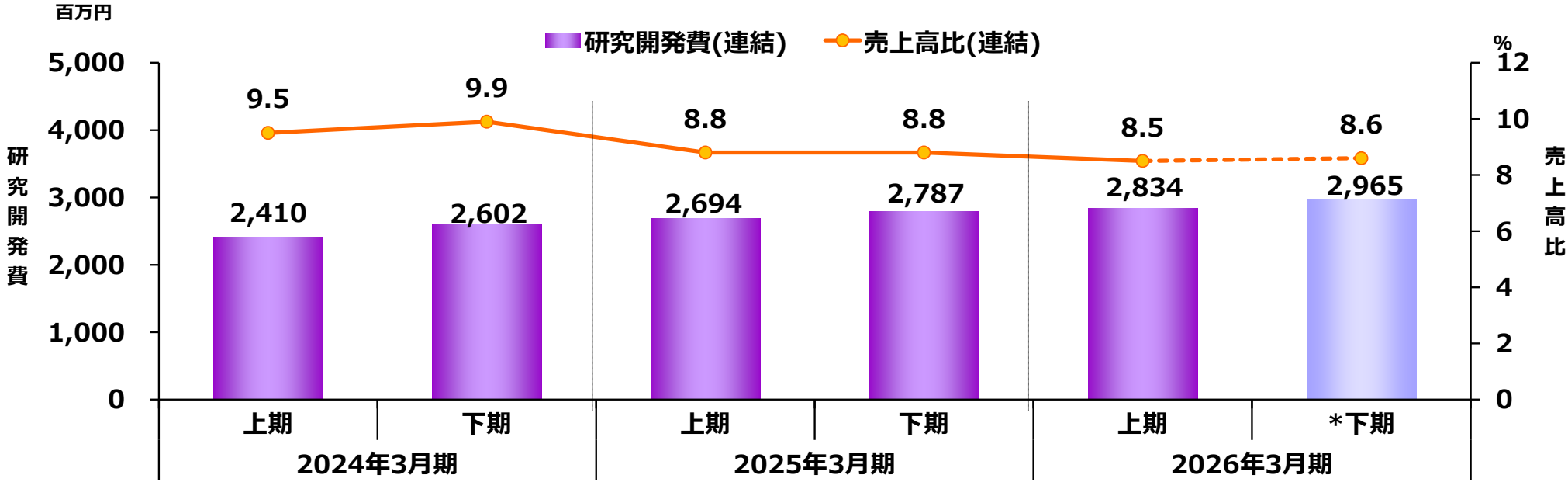
	25年3月期	26年3月期			
	通期実績	通期計画 ('25/5)	通期 修正計画	前期比	期初計画比
設備投資額	12,844	29,600	27,600	+114.9%	△6.8%
減価償却費	2,003	2,700	2,300	+14.8%	△14.8%



研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

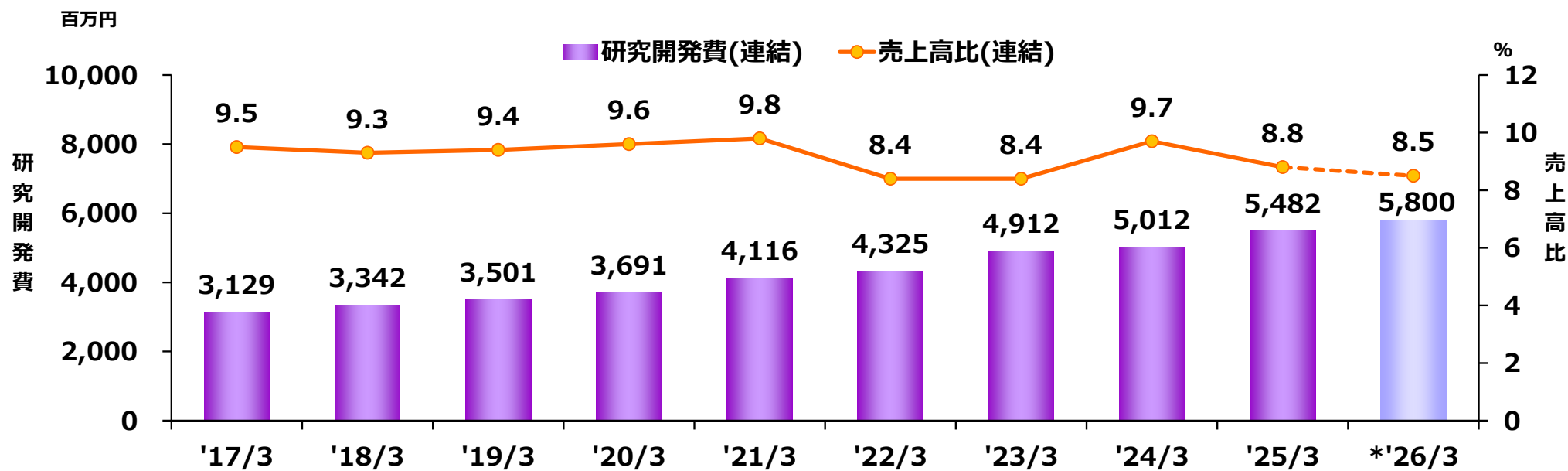
	25年3月期		26年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 (’25/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比	下期計画 (’25/5)	下期 修正計画	前年同期比	同年上期比	計画比
研究開発費	2,694	2,787	2,900	2,834	+5.2%	+1.7%	△2.3%	2,800	2,965	+6.4%	+4.6%	+5.9%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

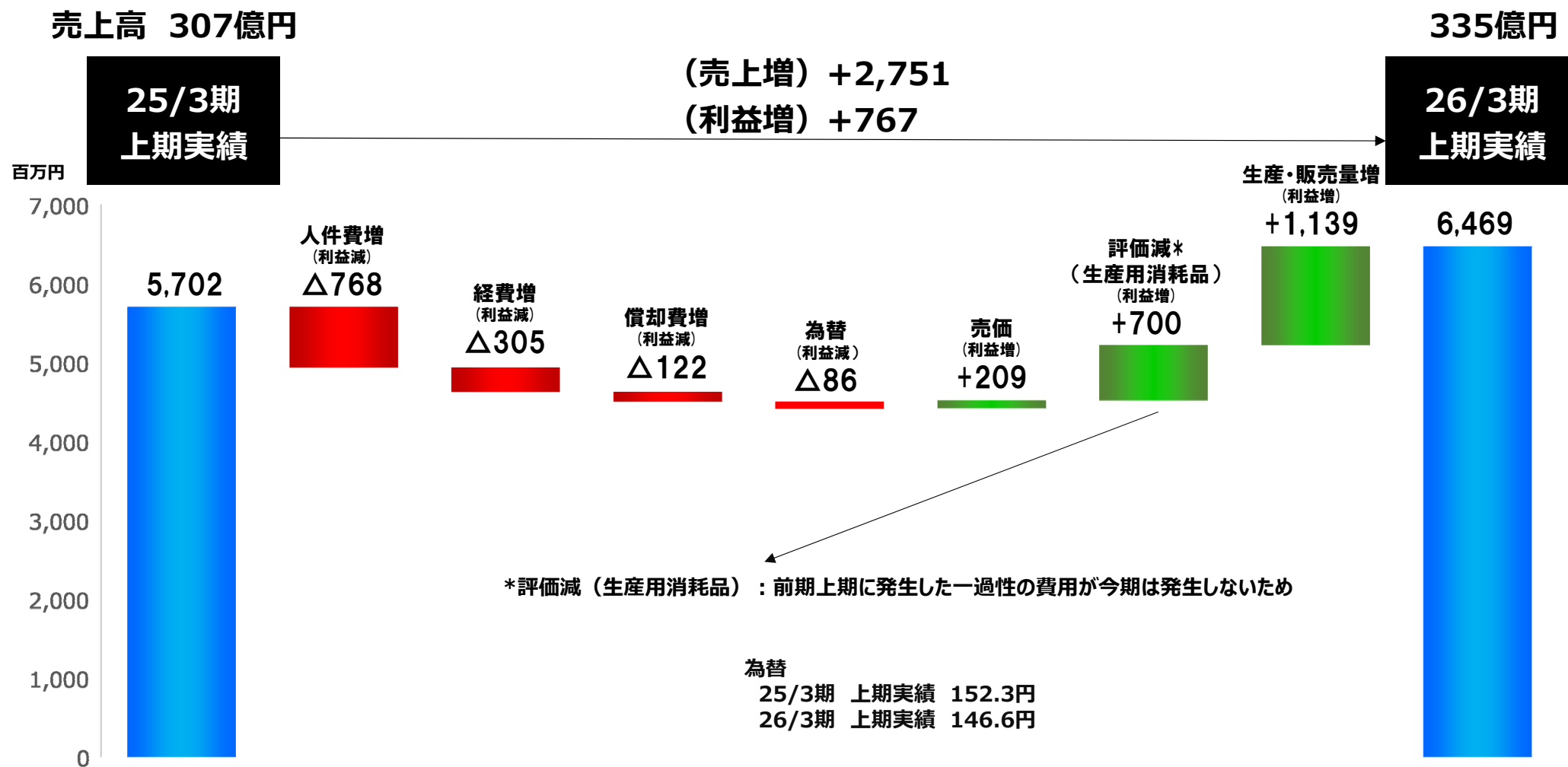
	25年3月期	26年3月期			
	通期実績	通期計画 ('25/5)	通期 修正計画	前期比	期初計画比
研究開発費	5,482	5,700	5,800	+5.8%	+1.8%



損益分析

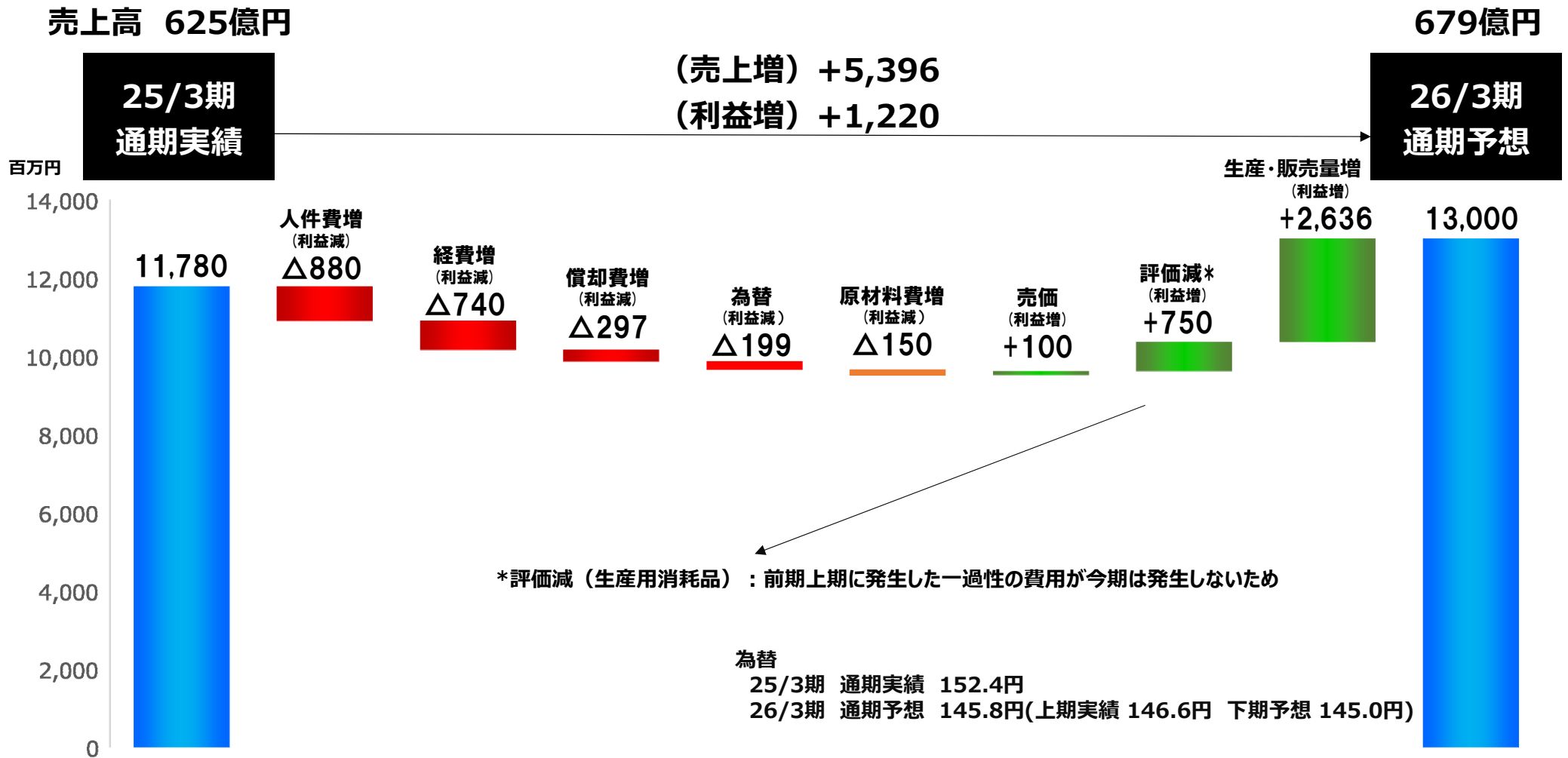
営業利益増減要因

25/3期上期実績 → 26/3期上期実績



営業利益増減要因

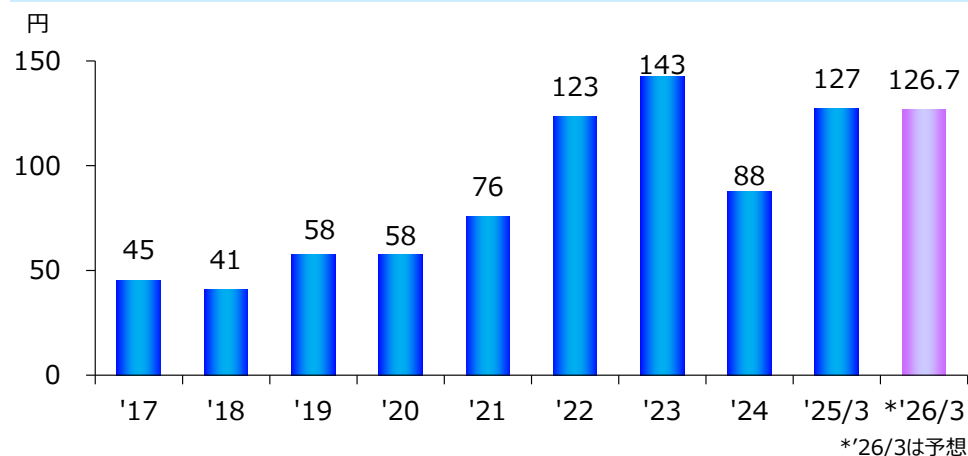
25/3期通期実績 → 26/3期通期予想



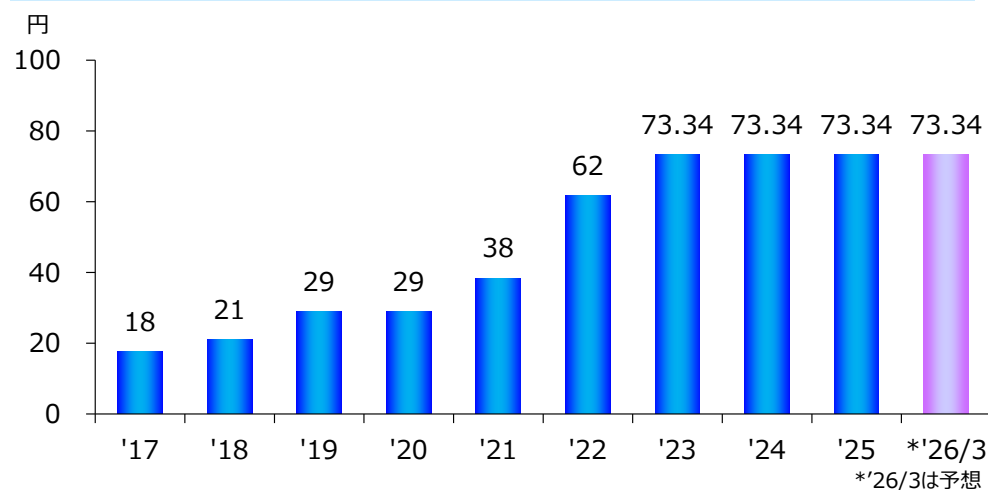
株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

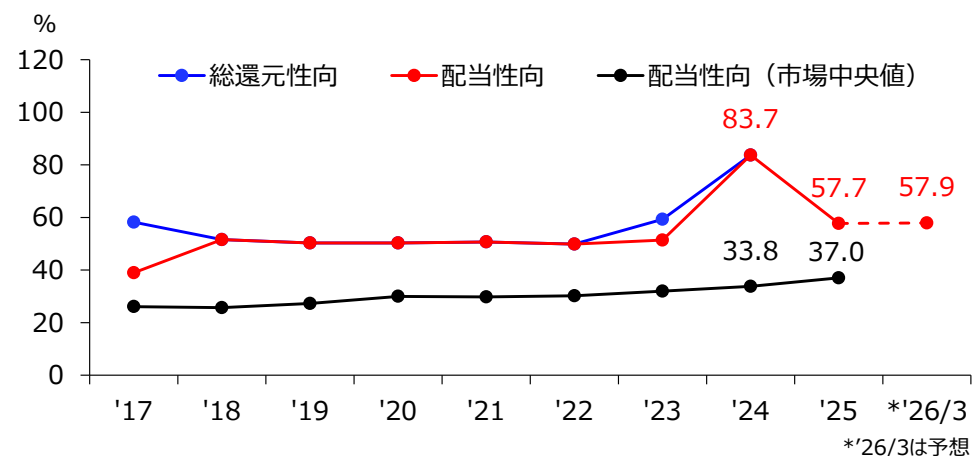
1 株当たり当期純利益（分割後）



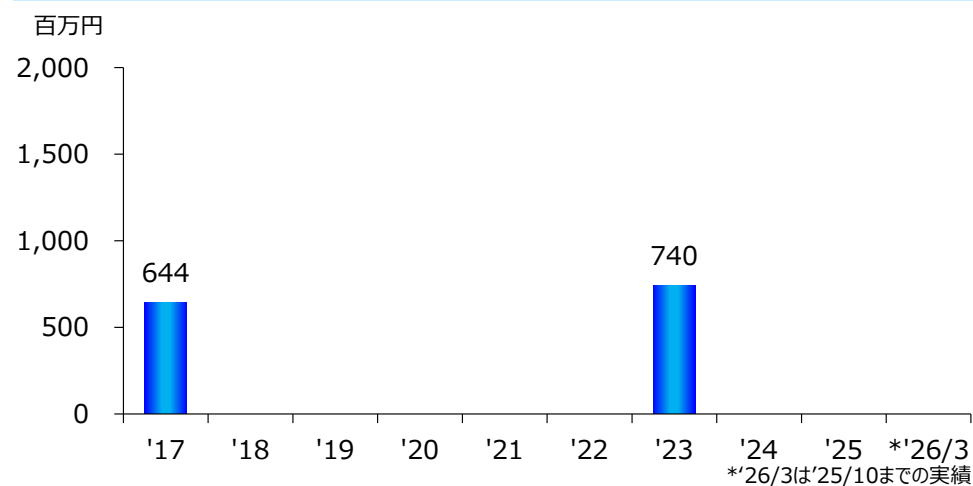
1 株当たり配当金（分割後）



総還元性向・配当性向



自己株買い



2026年3月期 上期業績サマリー／通期業績予想

*1 純利益：親会社株主に帰属する純利益 *2 EBITDA=営業利益+減価償却費

【2026年3月期 上期業績】 *前年同期比

✓ 売上高	*+8.9%	： 半期過去最高を更新
✓ 営業利益	+13.4%	： 費用増（将来を見据えた投資に伴う増（含む人員増））があるも、先端半導体向けCMP製品及びシリコンウェハー向けポリシング材を中心に売上増加により増益
✓ 経常利益	+11.3%	： 台湾ドルが他通貨に対して独歩高となったことによる一時的な為替差損あり
✓ 純利益*1	+6.9%	： 経常利益の+11.3%に対し、+6.9%。試験研究費控除制度変更等により控除額が減少したため
✓ EBITDA*2	+13.4%	：
✓ シリコンウェハー向け	+7.0%	： 先端向けの販売好調による増収
✓ CMP向け	+11.3%	： AI関連の先端ロジックや先端メモリ向けの販売好調による増収
✓ ハードディスク向け	△22.5%	： 顧客の生産プロセス改善の影響により、当社研磨材使用量が減少となり減収
✓ 一般工業用向け	+16.0%	： 前期に子会社化した南興セラミックスの売上合算及び研磨装置関連のスポット受注もあり増収
✓ 株主還元	： 1株当たり配当額は期初予想通りの36.67円	

【2026年3月期 通期業績予想】 **前年比

✓ 売上高	**+8.6%	： 先端半導体デバイス向けCMP製品及びシリコンウェハー向けポリシング材の販売増加を想定し、増収・
✓ 営業利益	+10.4%	： 増益を見込む
✓ 経常利益	+4.1%	： 台湾ドルが他通貨に対して独歩高となったことによる一時的な為替差損あり
✓ 純利益*1	△0.3%	： 前期は賃上促進税制による税軽減あり
✓ EBITDA*2	+11.0%	：

技術を磨き、心をつなぐ



FUJIMI INCORPORATED